



股票代號：3551

# 世禾科技股份有限公司 Shih-Her Technologies Inc.

## 法人說明會簡報

報告人：陳學哲 總經理

98年09月24日

# 簡報綱要

- 一、公司簡介
- 二、營運成果
- 三、未來研發及計畫

# 公司概況

- 創立時間：86年6月23日
- 董事長：陳學聖
- 總經理：陳學哲
- 資本額：新台幣389,047,850元
- 員工：台灣501人 大陸深圳廠50人
- 新加坡50人 昌昱25人
- 廠房：新竹一廠 新竹二廠 台南三廠 新竹四廠  
總使用面積6459坪
- 轉投資：昌昱(新竹) 世平(大陸深圳廠) 新加坡 Minerva
- 95年12月上興櫃
- 97年4月上櫃

# 營運佈局



# 營運佈局



世禾一廠：土地面積：539坪  
新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路 17 之 2 號



世禾二廠：土地面積：994坪  
新竹縣湖口鄉新竹工業區復興路30號



世禾三廠：土地面積：3,884坪, 台南市安南區台南科技工業區工業二路35號



世禾四廠：土地面積：1,007坪, 新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號

# 設備精密洗淨流程



# 精密洗淨及再生處理零組件種類

半導體生產  
設備零組件



TSMC 12" wafer Chamber



TSMC 8" Heater Chamber Lid



TSMC 12" Etcher Quartz Bell Jar

TFT-LCD生  
產設備零組件



Gen. 6<sup>th</sup> TFT Sputter Panel



Gen. 6<sup>th</sup> TFT Sputter Panel Holder



Gen. 7.5<sup>th</sup> Color Filter Module Masks

太陽能及硬碟  
生產設備零組  
件



SunPower 240KVA Solar Cell  
Panel Sputter Chamber Grid  
Tray



SunPower 240KVA Solar Cell  
Panel Sputter Chamber Trays



Trace Storage Hard Disc Driver  
Floppy Sputter Chamber Kids

# 主要客戶-半導體

SHT



UMC THE SoC SOLUTION FOUNDRY

inotera memories



MXIC



Winbond Electronics Corp.

ASE KAOHSIUNG

Maxchip 鉅晶電子  
Maxchip Electronics Corp.

台灣茂矽電子股份有限公司  
MOSEL VITELIC INC.

# 主要客戶-光電及太陽能



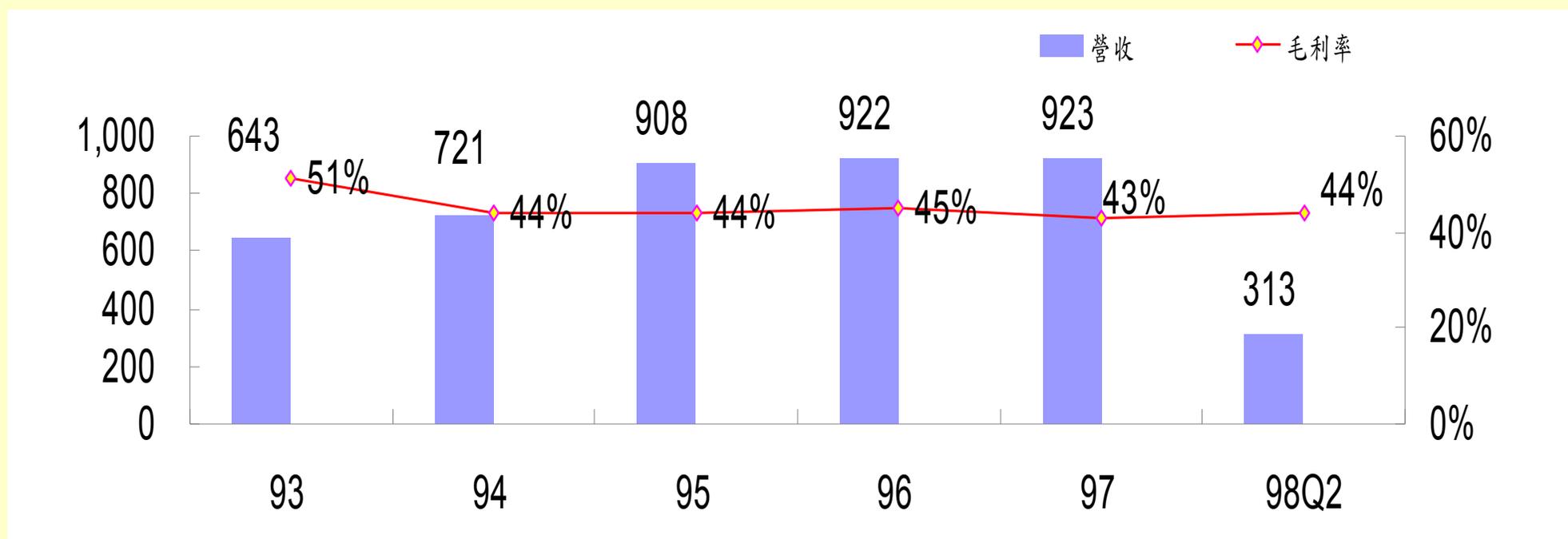
## 競爭利基

1. 潛在競爭者跨入門檻高
2. 精密洗淨及再生處理技術持續領先
3. 具經濟規模及專業分工優勢
4. 有效營運模式，易於快速複製

## 二、營運成果

# 年度營收及毛利率

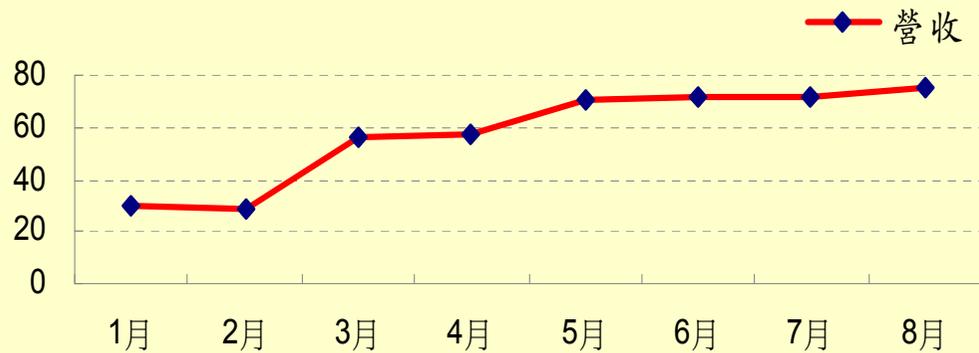
單位:百萬元



# 98年度營收趨勢連動性分析

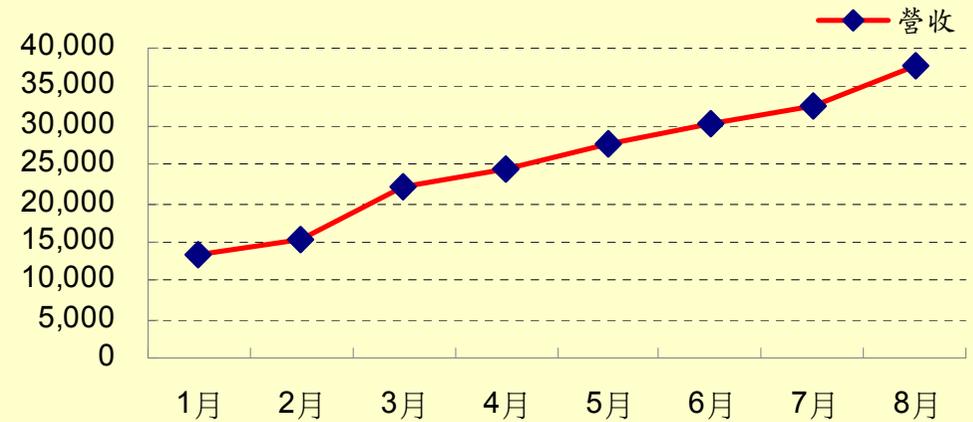


世禾

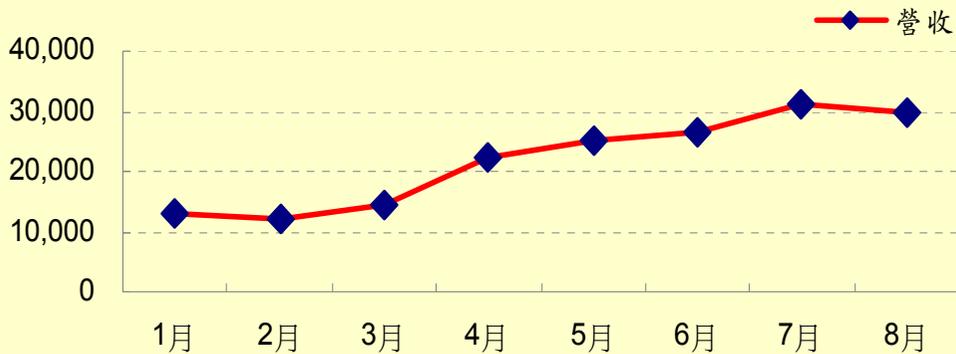


友達

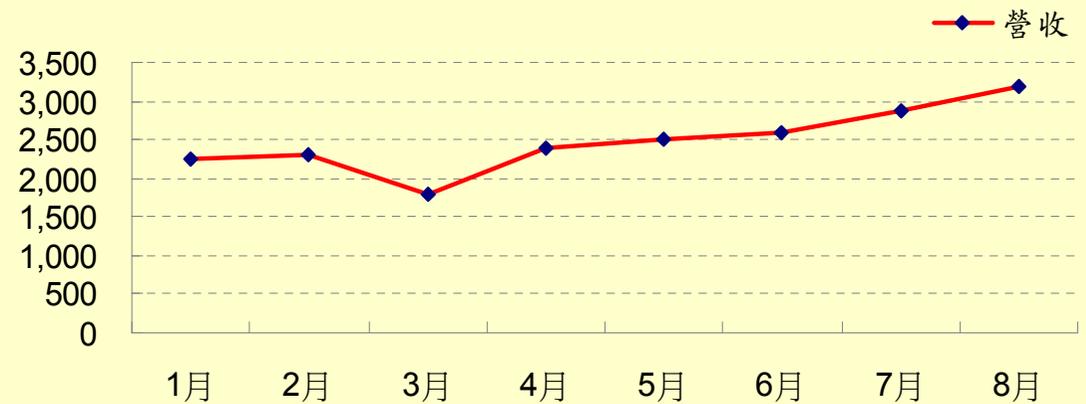
單位:百萬元



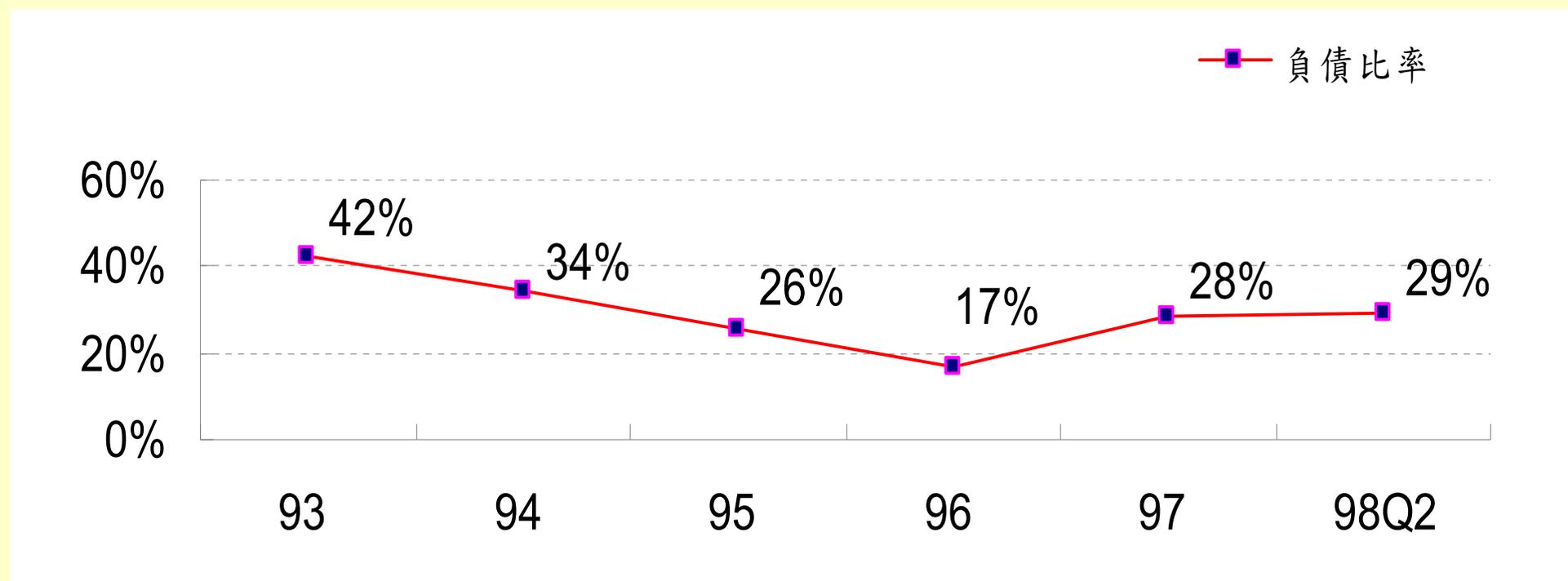
台積電



華亞科



# 負債比率分析



# 三、未來研發及計畫

# 研發成果



年度	研發成果
2008年	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="461 488 2049 715">1. 成功開發8吋晶元AMAT Endura機台之PVD Sputtering 電漿熔射Ti 塗層應用技術開發，有效提昇使用壽命50%以上。</li><li data-bbox="461 743 2049 970">2. 成功將高性能陽極處理技術（MLFC）分別應用於半導體及TFT-LCD 產業，有效提昇Etcher（蝕刻）機台元件之壽命30%以上。</li><li data-bbox="461 999 2049 1318">3. 分別於竹科及南科拓展本公司技術於太陽能電池面板產業之應用，於多晶、單晶及薄膜太陽能電池面板之應用領域之中，均成功地開拓了本公司洗淨技術之新市場。</li></ol>

# 未來研發計畫重點



## 研發專案

氧化鈮( $Y_2O_3$ )陶瓷保護塗層電漿熔射技術開發

Plasma Sprayed Yttria Protective Ceramic Coating  
Technology

下電極板陶瓷保護層電漿熔射製程開發

Plasma Sprayed e-chuck/embose Ceramic Coating  
Processes Technology

TA製程零組件技術開發

Systematic Surface Modification Technologies On 12" Wafer  
Encore Tandem Tan Sputtering System Components for Nano  
Applications

# 未來發展計劃



- **新事業版圖**

昌昱科技專業領域在於IC/TFT-LCD之ETCH/CVD製程設備零組件之陽極表面處理及清洗技術，市場占有率已漸發酵和擴大。

- **投入貴金屬回收研發**

銻、鉬、銅、鉍等貴金屬同時會披覆於工件上，世禾於清洗工件時將其集中回收，再委由下游配合廠商提煉為可再利用之成品，除為客戶解決廢棄物處理問題外，亦可以收益回饋給客戶以降低成本，目前銻回收為業界第一家取得合法處理途徑的公司。

# 未來發展計劃

- 跨入吸附材製作及買賣

半導體廠的PFCS廢氣高效處理之觸媒及吸附材製作及買賣，配合京都議定書協議。

- 大陸洗淨市場開發



# 世禾科技股份有限公司

## 簡報結束 Q&A

[www.sht.com.tw](http://www.sht.com.tw)